



2025年1月22日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢  
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)  
問 合 わ せ 先 IR・広報部長 野 田 耕 一  
( 0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6 )

**（開示事項の経過）半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社の上場申請  
取り下げに関するお知らせ**

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、2023年7月3日付「半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による深セン証券取引所主板市場への上場申請に関するお知らせ」にて開示した、半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社である寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司（以下、「FTNC」）による深セン証券取引所主板市場（以下、「深セン主板」）へ行った上場申請に関して、FTNCより上場審査状況などを総合的に勘案し上場申請を取り下げることとし、2025年1月21日に取引所より上場審査を終了する旨開示されましたので、お知らせいたします。

FTNCによる申請取り下げについては、最近の中国証券監督管理委員会のIPO審査の厳格化に及び足元の業績が計画を下回っていることに伴い、深セン主板の要求事項への対応状況から総合的に判断されたものです。引き続き、FTNCは業績回復を果たし、適切な時期に株式上場申請の再開を含め、企業価値向上に繋がる最適な資本政策を多面的に検討してまいります。

なお、本件による当社の今期連結業績および財務状況に与える影響は軽微であり、開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表します。

**【ご参考】FTNC 関連開示の履歴（上場および出資に関する事項）**

開示日	表題
2023/7/3	半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による深セン証券取引所主板市場への上場申請に関するお知らせ
2022/9/15	半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による上場申請市場及び上場アドバイザー契約先の変更に関するお知らせ
2022/5/17	半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による第三者割当増資（第三回）に関するお知らせ
2021/12/24	（開示事項の変更）半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による光大証券（主幹事証券）との上場に関するアドバイザー契約の締結、および 中国証券監督管理委員会による登録受理のお知らせ
2021/11/9	半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による光大証券（主幹事証券）との上場に関するアドバイザー契約の締結、および 中国証券監督管理委員会による登録受理のお知らせ
2021/9/24	（開示事項の変更）半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ ※（第2回）
2021/9/24	（開示事項の再訂正・変更）（開示事項の経過ならびに訂正）半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による第三者割当増資ならびに特定子会社の異動に関するお知らせ ※（第1回）
2021/8/6	半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ ※（第2回）
2021/4/15	（開示事項の経過ならびに訂正）半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による第三者割当増資ならびに特定子会社の異動に関するお知らせ ※（第1回）
2021/2/10	20210210_半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による第三者割当増資ならびに特定子会社の異動に関するお知らせ ※（第1回）

以 上